

スマートプロセス学会誌

目 次 Vol. 9 No. 5 2020 (令和2年9月)

Mate2020 特集号—第26回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム

会 告 N17

巻 頭 言 Mate2020 特集号によせて

西川 宏..... 209

研 究 論 文 プリント配線板におけるビア底部の再結晶化に及ぼす
無電解銅めっき皮膜中のニッケル含有率の影響

本間秀和・北原悠平・姜 俊行..... 210

パワーモジュール・ワイヤ接合部熱疲労強度評価に
修正ひずみ硬化則の適用

葉山 裕・宍戸信之・牛尾和也・萩原世也・宮崎則幸..... 216

Formation Mechanisms of Thermal Fatigue Crack Networks in
Sn-Ag-Cu Die-attach Joint in High Speed Thermal Cycling

Hiroshige SUGIMOTO, Yoshiharu KARIYA, Yoshiki ABE

Ryuichiro HANADA, Yoshinori YOKOYAMA and Shinnosuke SODA..... 224

原子層堆積法による極薄膜金属中間層形成を利用した
低温 Cu-Cu 疑似直接接合技術

手塚彩水・山田紘右・河合 Alaric 洋平・桑江博之

庄子習一・百瀬 渉・水野 潤..... 232

混流生産における投入順序・部品搬送統合化計画問題の効率的解法

森永英二・中村 匠・若松栄史..... 237

報 告 記 事 エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術シンポジウム
(Mate2020) 開催報告

松嶋道也..... 245

会報・掲示板 N18

Journal of Smart Processing
Vol. 9 No. 5 2020 (September 2020)

CONTENTS

Mate2020 特集号—第26回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム

S.P.S. Announcement N17

Preface Hiroshi NISHIKAWA..... 209

Research Papers

Effect of Ni Content in the Electroless Copper Plating Film on
Recrystallization at the Bottom of via in Printed Circuit Board
Hidekazu HONMA, Yuuhei KITAHARA and Joonhaeng KANG..... 210

Application of Modified Strain Hardening Rule to Thermal Fatigue Strength Evaluation of
Wire Bonding in Power Module
Yutaka HAYAMA, Nobuyuki SHISHIDO, Kazuya USHIO,
Seiya HAGIHARA and Noriyuki MIYAZAKI..... 216

Formation Mechanisms of Thermal Fatigue Crack Networks in
Sn-Ag-Cu Die-attach Joint in High Speed Thermal Cycling
Hiroshige SUGIMOTO, Yoshiharu KARIYA, Yoshiki ABE,
Ryuichiro HANADA, Yoshinori YOKOYAMA and Shinnosuke SODA..... 224

Low Temperature Copper-Copper Quasi-Direct Bonding Utilizing
Ultra-Thin Metal Interlayer Formation by Atomic Layer Deposition
Ami TEZUKA, Kosuke YAMADA, Yohei Alaric KAWAI, Hiroyuki KUWAE,
Syuichi SHOJI, Wataru MOMOSE and Jun MIZUNO..... 232

Efficient Method for Solving Integrated Planning Problem of
Sequence and Part Delivery in Mixed-Model Production Systems
Eiji MORINAGA, Takumi NAKAMURA and Hidefumi WAKAMATSU..... 237

Special Report for Mate 2019

Report on 26th Symposium on “Microjoining and Assembly Technology in Electronics”
Michiya MATSUSHIMA..... 245

S.P.S. News N18